



取付荷重：クロス掛け 2本使用時 7.4N~10.0N

条件：ヒートシンク ベース厚さ 3.0mm
 デバイス厚さ 3.0mm
 PCB(基盤)厚さ 1.6mm

材質 SUS304-CSP-1/2H T=0.5mm

尺度 SCALE	仕上 FINISH テンパー	材質 MATERIAL SUS304 1/2H	品名 NAME Miracle Clip	☉
承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWN 96, 11, 28 IWAKI	設計 DESIGNED	SHEET
			図面番号 DRAWING NUMBER MC3562	